

池州华宇电子科 CHI ZHOU HISEMI ELECTRON 焊线图纸 Bondin	技股份有限公司 IICS TECHNOLOGY CO.,LTD	客户代码 Customer No. 产品名称	线图号 Drawing No.	封装外型	GA24L(13.0×13.0×0.75	页码 Page 2/2 5-P1.20)
All Service And All Service A	MD Cap 330	产品名称 Product Type	A 太 Substrate	^{封褒外型} PKG Type I	GA24L(13.0×13.0×0.75	
	S		S			5
					and a second second second	
权制 Prepared by 研发审核 R&d check	制图日期 Create Date 产品工程审 Product engineerin		生效日期 Effective Date 批准 Approved by		客户确认签字/盖章: Customer Signature	